

博敏电子股份有限公司

关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”，公司持有其 100% 股权），为公司提供连带责任保证担保，金额为人民币 35,800 万元。深圳博敏已实际为公司提供的担保余额为人民币 13,840.84 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2020 年度拟向银行申请不超过 23 亿元人民币的综合授信额度。公司对深圳博敏的担保总额不超过人民币 1.6 亿元，公司接受深圳博敏的担保总额不超过 6.5 亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2020 年 4 月 29 日披露的公司《关于 2020 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临 2020-020）》和 2020 年 5 月 20 日披露的公司《2019 年年度股东大会决议公告（2020-033）》。

在上述授权范围内，公司因日常经营发展需要，向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信额度为人民币 37,800 万元，期限为一年（其中：中长期固定资

产贷款 23,800 万元，期限为 5 年），公司以部分自有房产及机器设备作为抵押，并由子公司深圳博敏为公司上述授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：博敏电子股份有限公司

注册地点：梅州市经济开发试验区东升工业园

法定代表人：徐缓

经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI 印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，博敏电子资产总额为 448,227.44 万元，负债总额为 201,619.31 万元，其中银行贷款总额为 71,033.58 万元、流动负债总额为 169,724.15 万元，净资产为 246,608.13 万元，2019 年营业收入为 266,928.81 万元，净利润为 20,155.71 万元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，博敏电子资产总额为 441,619.43 万元，负债总额为 193,139.01 万元，其中银行贷款总额为 68,360.17 万元、流动负债总额为 158,333.53 万元，净资产为 248,480.42 万元，2020 年一季度营业收入为 46,722.10 万元，净利润为 1,567.40 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

担保金额：人民币 35,800 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：最高额保证合同所确定的主债权发生期间届满之日起两年。

担保范围：基于主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足公司在经营过程中的资金需要，公司经营状

况稳定，资信状况良好，担保风险可控。深圳博敏为公司子公司，其为公司提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 312,622.96 万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 126.77%；公司对控股子公司提供的担保总额为 207,602.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的 84.18%。（未经审计、不含本次担保）

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日